T-32 SERVICE NOTES Third Edition

SPECIFICATIONS

Sound Sources Preset Tones Sampling Frequency

: 32 polyphonic 128 32KHz 15-bit linear

Current Draw Power Consumption (AC adaptor input)

Dimensions

Data Format -80dBm (IHF-A) or less @25°C (77°F) Noise Level 650mA @9V 10W @100V

9.5W @117V 10.5W @220-240V : 51 (H) x 305 (W) x 220 (D) mm 2 x 12 x 8-11/16 in (Including feet)

Weight Accessories

: 1.5 kg. 3 lb 6 oz : AC Adaptor

ACB-100 100V ACB-120 117V ACB-220 220V ACB-240A 240V (Australia) ACB-240E 240V (England) MIDI Cable (DIN Cord) (1m) 1 pc

Connection Cord LP-25 2 pcs Owner's manual (revised edition) Japanese (2701046600) English (2701046700)

PLEASE SEE PAGE 4 FOR DIFFERENCE BETWEEN MT-32 (NEW) and (OLD).

4頁の「MT-32新旧バージョンの相違点」を 参照して下さい。

APPLICABLE TO THE FOLLOWING SERIAL NUMBERS 第三版は下記の製品のみを対象に解説しています

SN F950500-F950999 SN E969000-UP

The products with these serial numbers have a PHONE jack. The main board(7937731001, new type) is employed for the

このシリアルナンバーの製品にはヘッドホンジャックが付いて います。メイン基板には新タイプのパーツナンバー7937731001 が使用されています。

("ミュージくん"用 MT-32については下記参照)

- Japanese only

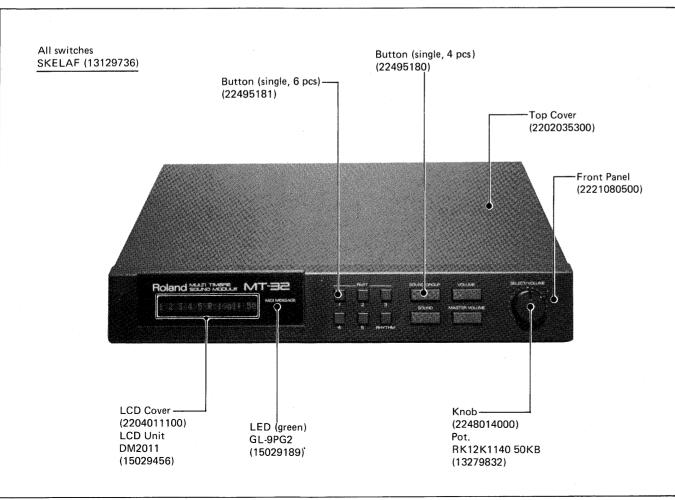
"ミュージくん"用 MT-32 DM-32N-3 Z940150 以降 DM-32N-4 Z943600 以降 DM-32N-7 Z940750 以降

但し下記のシリアルナンバーの製品にはヘッドホンジャックは付いていま せん。メイン基板には新タイプのパーツナンバー7937731001が使用されて いますが、ヘッドホンジャックは取り除かれています。

11頁の"変更案内"を参照してください。 "ミュージくん"用 MT-32

DM-32N-3 Z940150 - Z940249 DM-32N-4 Z943600 - Z944599

DM-32N-7 Z940750 - Z941149



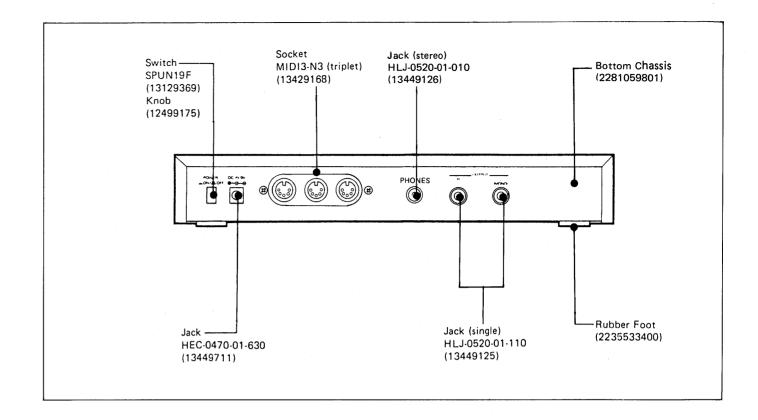
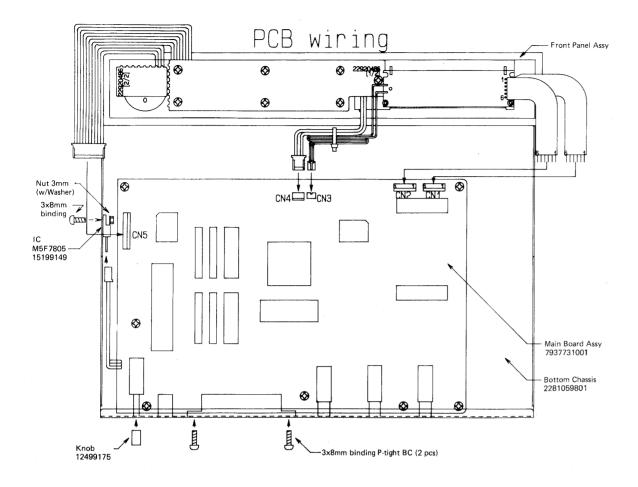


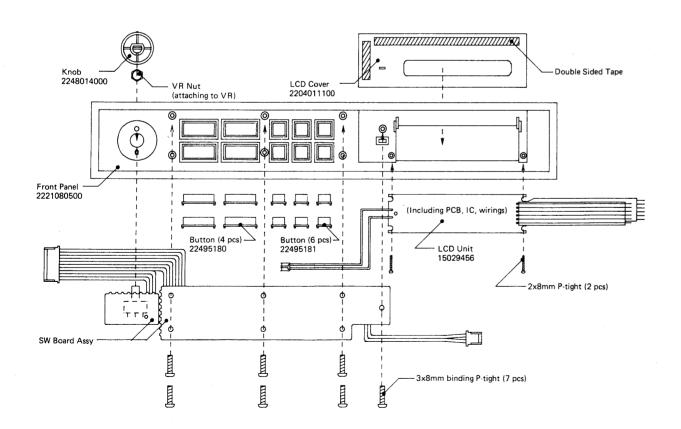
TABLE OF CONTENTS

月 次

EXPLODED VIEW	
CIRCUIT DESCRIPTION	
BLOCK DIAGRAM	
DIFFERENCE BETWEEN MT-32 (NEW) and (OLD)	
PARTS LIST	
TEST MODE	
LCD UNIT	
SW BOARD	
VR BOARD	
MAIN BOARD	
IC DATA	
CHANGE INFORMATION	

Γά	ge
分解図2	
回路解説3	,
ブロック図3	,
M T-32新旧バージョンの相違点······ 4	
パーツリスト4,5	ı
テストモード6,7	,
LCDユニット······7	
スイッチ基板7	
ボリウム基板7	
メイン基板8,9	
I C データ10	j
変更案内11	L





Viewing at rear of unit

EXPLODED VIEW

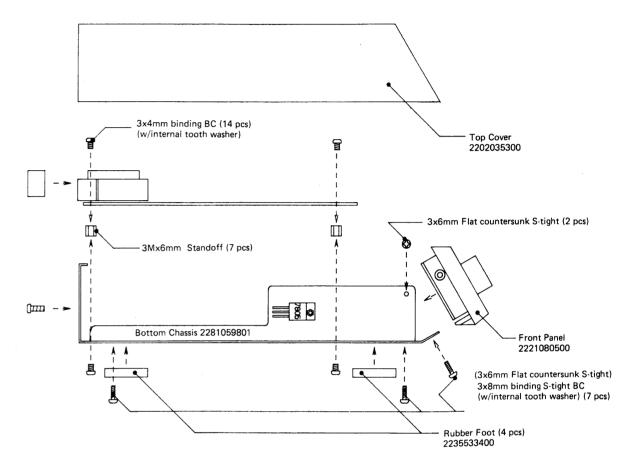
NOTE

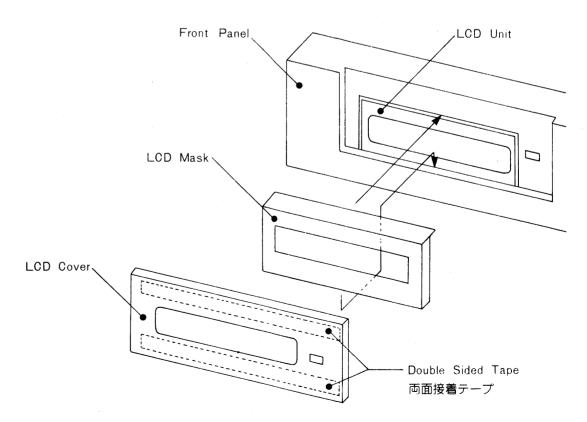
When inserting or pulling out flat cable at CN1 or CN2, push lock mechanism at the connector.

分解図

注意

CN1,CN2上でフラットケーブルを抜き差しする場合は、コネクタ上のロックを押して下さい。





CIRCUIT DESCRIPTIONS

*1 *2 *3 = (1)(2)(3) (Fig. 1, Table 1)

CPU (IC34, Main board) processes MIDI IN data by running the operational program (stored in IC28 (ROM)) and reading sound parameters and other sound related data. Then the CPU (IC34) directs the LA chip IC36 to generate and output the necessary sound. The LA chip places the sound data on the data bus (SD1 – SD15) connecting to both the Reverb chip IC17 and DAC IC8. (The sound data won't be output on the data bus (SD0) because the data is 15-bits data.)

The LA chip works in timesharing: It outputs data on the clock SH1 which in combination with SH2 and SH3 makes channel select code. If a data is to be reproduced as a direct sound only, the chip places the data during time slots 2 and 6. If reverb effect is required, then slots 1 and 5. The data put out during slot 1(5) is not only accommodated by the reverb chip IC17(*2) but also routed to DMUX(*1) where it is delivered to the correct S/H circuit on the code SH1 — SH3, as a direct sound. Its reverb counterparts (16-bits data) are placed on the data bus when time slot 7(8) comes.

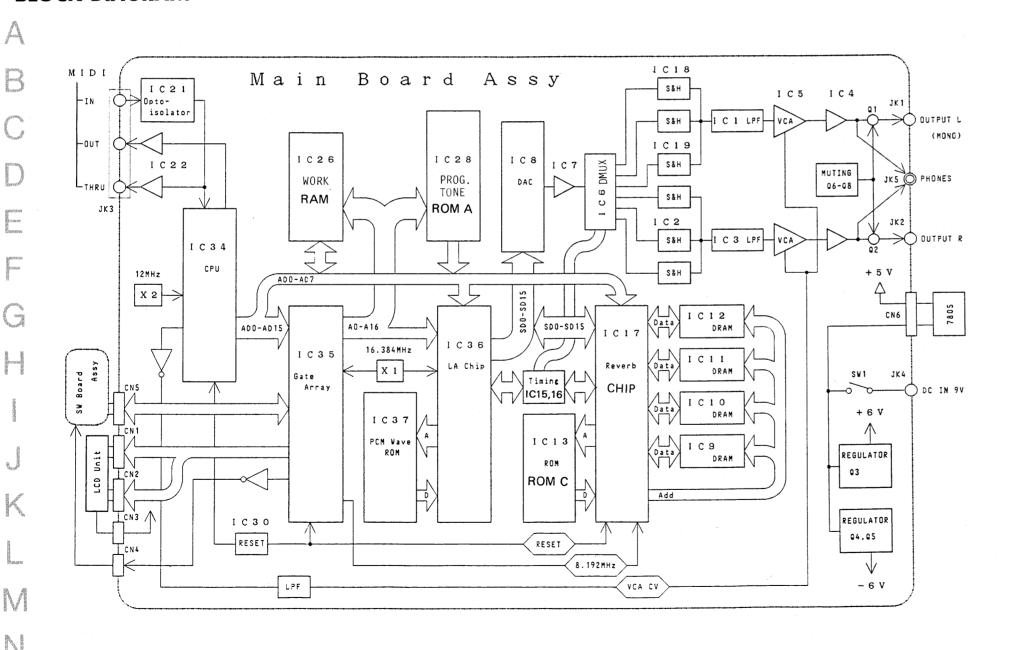
回路解説

CPU(IC 34)は、ROM(IC 28)のオペレーショナル・プログラムと音色パラメーター・データに基づいて、MIDI~INデータを処理し、その結果に応じたサウンド出力命令をLA Chip (IC 36)に与える。

LA Chipは、サウンド・データをSD1 — SD15から出力するが、方法は時分割方式で、SH1に同調させている。(シンセ音は15ビット・データなので、SD0には出力しない)。 Revを伴わない音の場合は、タイム・スロットの2と6で出力される。Revを伴う音は、スロットの1と5で出力される。後者の場合、データはRev Chipに取り込まれる**²とともに、DMUXへも送られ*、SH1—SH3からなるセレクト・コードで、目的のS/H回路へダイレクト音として加えられる。一方、Rev Chipで得られたリバーブ効果音(16ビット・データ)は、スロット7と8で出力される**。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BLOCK DIAGRAM



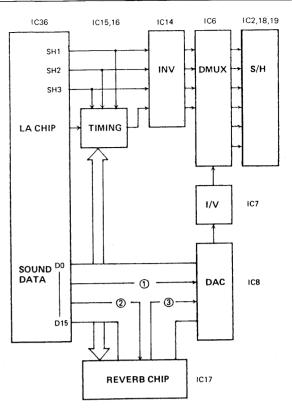


Fig.1

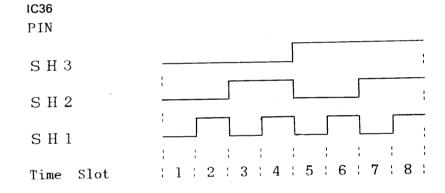


Fig.2

Time	Signal Flow		DMUX Output	
Slot			Pin	Sound
1	1	2	4	R SYN1
2	1		2	R SYN2
3	no sound			
4	no souna			
5	1	2	12	L SYN1
6	1		15	L SYN2
7	3		1.4	R REV
8	3		13	L REV

Table 1

DIFFERENCE BETWEEN MT-32 (NEW) AND (OLD) MT-32新旧バージョンの相違点

Difference between MT-32(without PHONES jack) and (with PHONES jack) MT-32 (PHONESシ ャック無し) と (PHONESシ ャック付) の相違点

	MT-32(without PHONES)	MT-32(with PHONES)		
	(フォーンジャック無し) [OLD]	[NEW] (フォーンシ゛ャック付)		
Serial No. יולעדער -	* MT-32 Prior to 938999 inclusive 938999以前 (938999を含む) * ミューシ (ん用 (Japanese only) DM-32N-3 Z940249 以前 DM-32N-4 Z944599 以前 DM-32N-7 Z941149 以前	* MT-32 F950500 - F950999, E969000 - UP F950500 からF950999 と E969000以降 * ミューシッと 人用 (Japanese only) DM-32N-3 Z950250 以降 DM-32N-4 Z954600 以降 DM-32N-7 Z951150 以降		
Bottom Chassis ホ"トムシャーシ	Part No.2281059800 without a hole for PHONES ^ッドや用の穴は有りません。	Part No.2281059801 with a hole for PHONES ^ッドホン用の穴が追加されています。		
Main Board メイン基板	Part No.7937731000	Part No.7937731001		
ア 1.2 金 W	* Main Board(7937731001) is completely different from (7937731000) in circuit design. But Main Board(79377310001) from which PHONES jack(JK5) is removed is compatible with (7937731000). * Only (7937731001) will be supplied for replacement. For MT-32(prior to SN938999) which has no PHONES jack, PHONES jack(JK5) on Main board(7937731001) must be removed. * メイン基板 新(7937731001)と旧(7937731000)とは回路が全く違いますが, (7937731001)から ヘット゚ホッンジャックを取り去れば基板単位での差替えが可能です。 * 補修用としては(7937731001)のみが供給されます。シリアルナンバー 938999以前の製品(^ット゚ホッンジャック無し)に使用する場合は, フォーンジャック(JK5)を取り去って使用して下さい。			
SW Board スイッチ基板	sa:同			
Function 機能		* ROM play(demonstration) mode is added. * Noise level is reduced (when VOLUME is not at maximum position). * PHONES jack is added. * ROMプ レイモート が追加されました。 * 小中音量時のノイス が低減されています。 * PHONESジャックが追加されました。		
Gate Array ケートアレイ (IC35) (Main Board)	* Both HG61H15B-59F and HG61H15B-72F can be used. * HG61H15B-59F と HG61H15B-72F の両方 が使用出来ます。	* Only HG61H15B-72F can be used. HG61H15B-59F can not be used. * HG61H15B-72Fのみ使用出来ます。 HG61H15B-59Fは使用出来ません。		
Reverb ROM (IC13) (Main Board)	* Mask ROM HN623257PC21 (15179857) or EPROM M5M27C128-15 (15449109)	* Mask ROM HN623257PZ21 (15179917) Incompatible with		

PARTS LIST

SAFETY PRECAUTIONS:

The parts marked ⚠ have safety-related characteristics. Use only listed parts for replacement.

安全上の注意:

⚠が付いている部品は、安全上特別な規格でつくられたものです。 <u>一交換の際は、注意をよく読み、指定された部品番号以外の部品は</u> 使わないようにして下さい。

CASING

2202035300

Top Cover

2281059801 Bottom Chassis (SN F950500 - F950999, E969000 - UP)

NOTE: Differnce between Bottom Chassis(2281059801) and (2281059800)

ボトムシャーシ(2281059801)と(2281059800)の違い

Serial No.	Part No.	Bottom Chassis
Prior to 938999 inclusive	2281059800	without a hole for PHONES ヘッドホン用の穴は有りません。
F950500 - F950999 E969000 - UP	2281059801	with a hole for PHONES ヘッドホン用の穴が追加されています。

2221080500 2204011100 Front Panel LCD Cover

Main Board

PCB ASSY

7937731001

(pcb 2292065100)

NOTE: Differnce between Main Board(7937731001) and (7937731000)

メル基板(7937731001)と(7937731000)の違い

Serial No.	Part No.	Bottom Chassis
Prior to 938999 inclusive	7937731000	without PHONES jack ヘット、オンシ、ャック無し
F950500 - F950999 E969000 - UP	7937731001	with PHONES jack ヘッドホン付き

- * Main Board(7937731001) is completely different from (7937731000) in circuit design. But Main Board(7937731001) from which PHONES jack(JK5) is removed is compatible with (7937731000).
- * Only (7937731001) will be supplied for replacement. For MT-32(prior to SN 938999) which has no PHONES jack, PHONES jack(JK5) on Main Board(7937731001) must be removed.
- * メイン基板(7937731001)と(7937731000)とは回路が全く違いますが、(7937731001)からフォーンジャック を取り去れば互換性が有ります。
- * 補修用としては(7937731001)のみが供給されます。シリアルナンバ- 938999 以前の製品 (フォーンジャック 無し)に使用する場合は,フォーンジャック(JK5)を取り去って使用して下さい。

7937742000

SW Board

(pcb 2292048600) (including VR board)

VR基板を含む

LCD UNIT

15029456

DM2011(including PCB, IC, Connector and Cable) No replacement for individual parts.

PCB, ケーブル, IC, コネクタを含む。これらの単独補修部品は有りません。

MT-32

2248014000		ELACT/VOLUME
12499175	_	OWER
22495181		ART
22495180	Button S	OUND GROUP, VOLUME, SOUND, MASTER VOL
WITCH		
∆ 13129369	SPUN19F P	OWER
13129736	SKELAF P	ART, SOUND GROUP, SOUND, MASTER VOL
ACK		
13449125	HLT-0520-01-11	O OUTPUT
13449126	HLT-0520-01-01	O PHONES
13449711	HEC-0470-01-63	O DC IN
13429168	MIDI3-NS (trip	let) MIDI
;		
15179286	P8098	CPU
15229896	LA32(MB87136A)	LA Chip
15239106	HG61H15B72F	Gate Array
15229863	HG61H20R36F	Reverb Chip
15219178	PCM54HP-S	D/A Converter
15449121	TC534000P-7476	4M Mask ROM (PCM)
or	HN62304BPE26	
15179944	LH5310** EP-ROM	1M Mask ROM (Program, Tone) ROM A IC28 on Main Board
	Different ROMs F	on IC28
NOIE:		ayout around ROM(IC28) and its associated circuits were
	main board rub i	
	originally desig	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory
	originally desig capacity, less-p	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted.
	originally desig capacity, less-p For this reason,	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM.
	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)
注:	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.) について
注:	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって
注:	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが、実際の	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ,
注:	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53IO**) の2種類	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 動が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー
注:	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 パン基板上のROM(I いますが,実際の LH53IO**) の2種類 においても,この	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 気が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパーセ
注:	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 パン基板上のROM(I いますが,実際の LH53IO**) の2種類 においても,この	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 動が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー゙
注: 15179374N0	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**) の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパーー゙2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM
· •	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メル基板上のROM(I いますが,実際の LH53IO**) の2種類 においても,この が異なりますので	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー² 2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C
151 79374 N0	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**) の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (280)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 気が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー゚ 2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM
15179374N0 15179917	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが、実際の LH53I0**) の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 類が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ,気が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR
15179374N0 15179917 15179345 15169515	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが、実際の LH53I0**) の2種類 においても、この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 類が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 類が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**) の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC04P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC04P TC74HCU04P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC04P TC74HCU4P TC74HCU7P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HCU04P TC74HC27P HD74LS05P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 系が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メウ基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって製品において、ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メウ基板上のROM(I いますが,実際の LH53I0**)の2種類 においても,この が異なりますので µPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC07P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において, ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 系が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが, 実際の LH53I0**) の2種類 においても,この ルPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(IC28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 気が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが, 実際の LH53I0**) の2種類 においても,この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HCU04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (288)部分における基板ラルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual VCA
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147 15189188 15219181 15199149	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが、実際の LH53I0**)の2種類 においても、この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D M5238L M5207L01 M5F7805	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について C28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 類が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter With Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Oual OP Amp OP Amp
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147 15189188 15219181	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが、実際の LH53I0**)の2種類 においても、この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D M5238L M5207L01 M5F7805	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (C28)部分における基板ラルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual VCA
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147 15189188 15219181 15199149	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが、実際の LH53I0**)の2種類 においても、この が異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D M5238L M5207L01 M5F7805	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (288)部分における基板ラルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual VCA
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147 15189188 15219181 15199149 RANSISTOR	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w ROM (IC28 メイン基板上のROM(I いますが, 実際が においても, このが異なりますので μPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D M5238L M5207L01 M5F7805	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (C28)部分における基板ラルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual VCA
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147 15189188 15219181 15199149 RANSISTOR	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w R O M (I C 2 8 以上 基板上のROM(I いますが、実際のは比53I0**)の2種類においても、このが異なりますのでルPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC00P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D M5238L M5207L01 M5F7805	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (C28)部分における基板ラルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual VCA
15179374N0 15179917 15179345 15169515 15169516 15169514 15169512 15169537 15169334H0 15159113H0 15219183 15229706S0 15189171 15189147 15189188 15219181 15199149 RANSISTOR	originally desig capacity, less-p For this reason, When replacing w R O M (I C 2 8 以上基板上のROM(I いますが、実際のはH53I0**)の2種類においても、このが異なりますのでμPD43256C-12L HN623257PZ21 M5M4416P-12 TC74HC00P TC74HC02P TC74HC04P TC74HC27P HD74LS05P HD14051BP M51953A PC910 M5218P NJM-072D M5238L M5207L01 M5F7805	ned to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory in but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. ith different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1 of page 8.)) について (C28)部分における基板ラルク図及びパターン図はEP-ROM (32ピンタイプ) 対応になって 製品において、ROM(1C28)はEP-ROM (32ピンタイプ) 及びMask ROM (28ピンタイプ, 乳が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サーピスパー2種類のうちいずれかで供給します。ROM交換時は、EP-ROMとMask ROMではピン数 8頁のFig.1に従い注意して行ってください。 S RAM 256k Mask ROM (Reverb) ROM C D RAM Quad 2-Input NAND Quad 2-Input NOR Hex Inverter Hex Inverter Triple 3-Input NOR Hex Inverter with Open Collector Output MUX/DEMUX Reset Optoisolator Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual OP Amp Dual VCA

DIODE	100 100	
15019125	1SS-133	
15039106	1SR35-100HM	
15019406	MTZ6.8B-T77	Cld Doord
15019103	182473	SW Board
15029189	GL-9PG2	LED green
COIL		
12399501M1	BL02RN-R62	EMI Filter
₼ 12449290	LT8-NO3W	EMI Filter
12449305	ECE-A 330MA	DC-DC Converter
13529105M1	DSS310-55D223S	EMI Filter
X'TAL		
12389717	12MHz	СРИ
15299108	16.384MHz	LA Chip, Reverb Chip
POENTENTIO	METER	
13279832	RK12K1140 50kB	
RESISTOR		
13919303	RMLS8-333J	3.3k x 8
13819143	5.6 ohm 1/2W	
13819149	10 ohm 1/2W	
10010110	10 01 1, 0	
CAPACITOR		
1363915380	470 µ F/16V	electro
13639154S0	1000 µ F/16V	electro
13649103J0	$10 \mu F/16V$	Bi-Polar
13649107S0	47 μ F/16V	Bi-Polar
CONNECTOR	-	
13439119	5045-03A	3P(to LED)
13439126	5045-10A	10P(to SW Board)
13439333	IL-S-2P-S2T2-EF	2P(to LCD)
23430525	52011-0610	6P(to LCD)
CONNECTOR	(w/leads)	
23410578	# 578	3P(to M5F7805)
23410577	#577	3P(from LED)
23410576	#576	10P(from SW Board)
AC ADAPTOR	1	
△ 12449546	ACB-100	100V
△ 12449547	ACB-120	117V
△ 12449548	ACB-220	220V
△ 12449549	ACB-240A	240V (Australia)
△ 12449564	ACB-240E	240V (England)
MISCELLANE	OUS	
		3 x 6mm
22150512 22355334	OUS Boss Nut Rubber Foot	3 x 6mm

Error を無視し、次のテ

ストを実行する場合は、

MASTER VOLUME &

押しながら VOLUME を

ゲートアレイ: IC35

押す。

要点検

TEST MODE

テストモード

ROM Revision Number

Press and hold PART 4, RHYTHM and MASTER VOLUME simultaneously, then turn the power on. The LCD will show Version Number and Date.

Press any key to return to play mode.



ROMバージョン・ナンバー

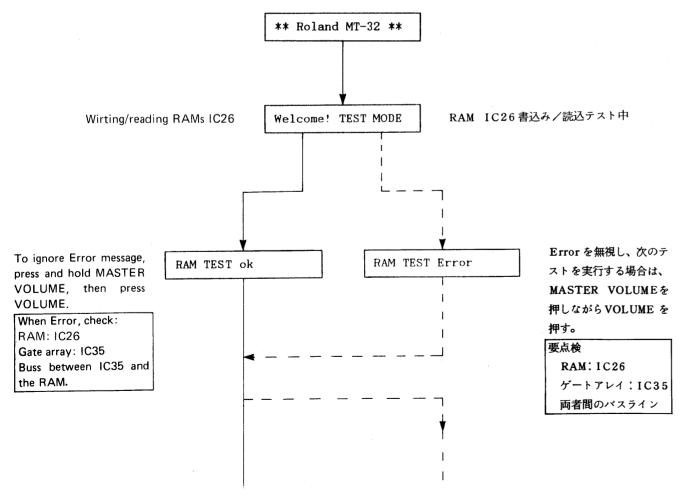
PART 4, RHYTHM およびMASTER VOLUMEを同時に押えながら電源を入れ ると、ROMバージョンを表示する。 どれかのボタンを押すと、プレイモードに 入る。

Checking

- 1 Hookup together MIDI OUT and MIDI IN sockets with the MIDI cable.
- 2 Press and hold PART 3 and VOLUME buttons, then apply the power, holding the two buttons until the LCD reads Welcome!

点検

- 1. MIDI OUTとMIDI IN ソケットを MIDIケーブルで接続する。
- 2. PART 3 と VOLUME ボタンを押しながら 電源を入れ、Welcome のメッセージが表 示されたら2つのボタンを離す。



To ignore Error message. BANK SELECT ok BANK SELECT Error press and hold MASTER VOLUME, then press VOLUME. When Error, check gate array, IC35. MIDI MESSAGE LEDが点滅する。 MIDI MESSAGE LED should blink CHECK LED PUSH 1 エラー Error indication Lighting LED: Check IC22 点灯…… IC22(LS05) 点検 Dead LED: Check LED, IC22 and 消灯……LED, I C22, コネクタ CN4 点検 Connector CN4. 3 Press PART 1. 3. PART 1を押す。 The LED might go off depending on which (MIDI MESSAGE LEDIA PART 18 half cycle of the scanning pulse the switch 押すタイミングによって消灯することもあ has been pressed. る) PUSH PART[1] Ready for switch scanning スイッチの読込みテスト開始 4 Press the panel switches one by one as indicated by LCD.

4. 表示に従ってボタンを押して行く。

SW TEST ok

CHECK VR PUSH 2:***

Error indication Reading won't change Check:

Panel switches, panel diode, IC35.

5 Turn SELECT/VOLUME knob and verify

proportional change in number at *** in

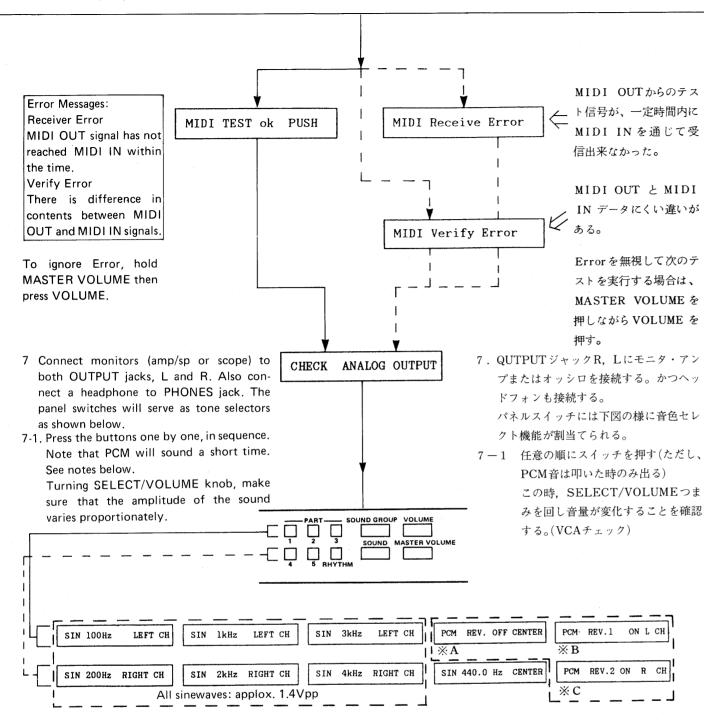
the LCD. It can change from 0 upto 100.

6 Press PART 2.

エラー 表示が変らない場合 要点検 パネルスイッチ、パネルダイオード、IC35 (ゲートアレイ)

5. SELECT/VOLUMEをまわし、※※※が 0~100と変化することを確認。

6. PART 2を押す。



NOTES

- *A Direct sound only; from both OUTPUTs.
- *B Direct and light reverb sounds from OUTPUT L. From R, reverb only.
- *C Direct and deep reverb sounds from OUTPUT R. From L, deep reverb only.

440Hz

There is a slight difference in volume between R and L OUTPUTs.

L approx. 1.6Vpp R approx. 1.2Vpp

8. When the tests has been completed, turn the power off once and on again to return to the play mode.

- ※ A……PCM音(TOM)の直接音のみが両方のジャックから出る。
- ※B……ジャックLからは直接音と、浅いリバ ーブ音が出る(TOM)

ジャックRからは浅いリバーブ音のみ

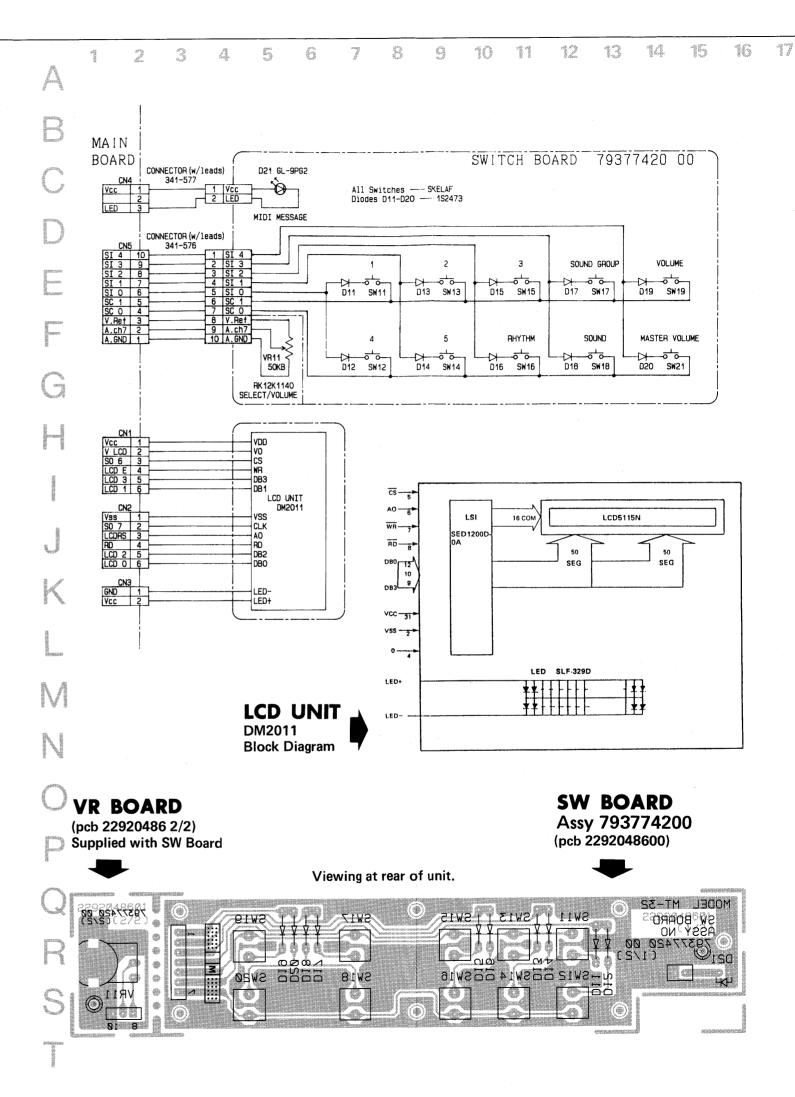
※ C……ジャックRから直接音と深いリバーブ 音が出る(TOM)

> ジャックLからは深いリバーブ音のみ が出る。

440Hz の出力はLとRで若干差がある。

L····約1.6 Vpp R····約1.2 Vpp

8. テストが終了したら、一旦電源を切り再び入れなおすとプレイモードに戻ることが出来る。



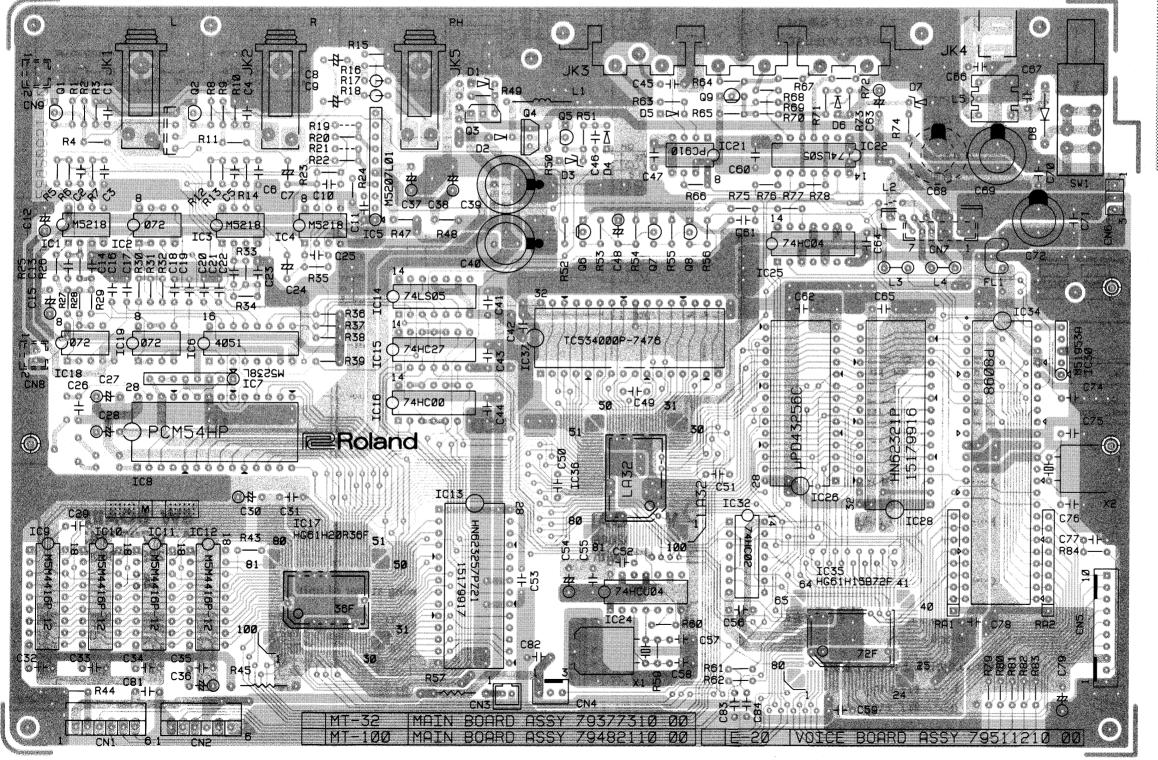
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <mark>17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38</mark>

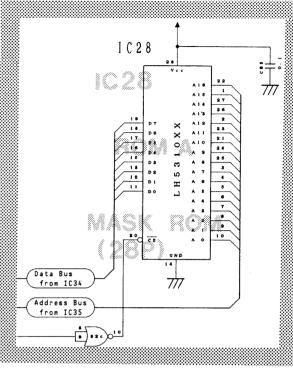
MAIN BOARD

ASSY 7937731001 (pcb 2292065100)

- SN F950500—F950999
 SN E969000—UP

 Japanese only
- ミュージくん用 SN Z940150-UP・・・・ DM-32N-3 SN Z943600-UP・・・・ DM-32N-4 SN Z940750-UP・・・・ DM-32N-7
- * Refer to page 4 "DIFFERENCE BETWEEN MT-32 (NEW) AND (OLD).
- *4頁の「MT-32新旧バージョンの相違点」を参照して下さい。





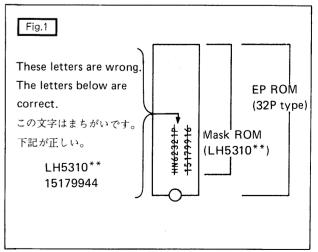
Different ROMs For IC28

Main board PCB layout around ROM(IC28) and its associated circuits were originally designed to work with EP-ROM (32P type). On some PCBs, less-memory capacity, less pin but compatible Mask ROM (28P type, LH5310**) is mounted. For this reason, replacement ROM will be either EP-ROM or Mask ROM. When replacing with different ROM, be sure to insert in place. (See Fig.1.)

ROM(IC28) について

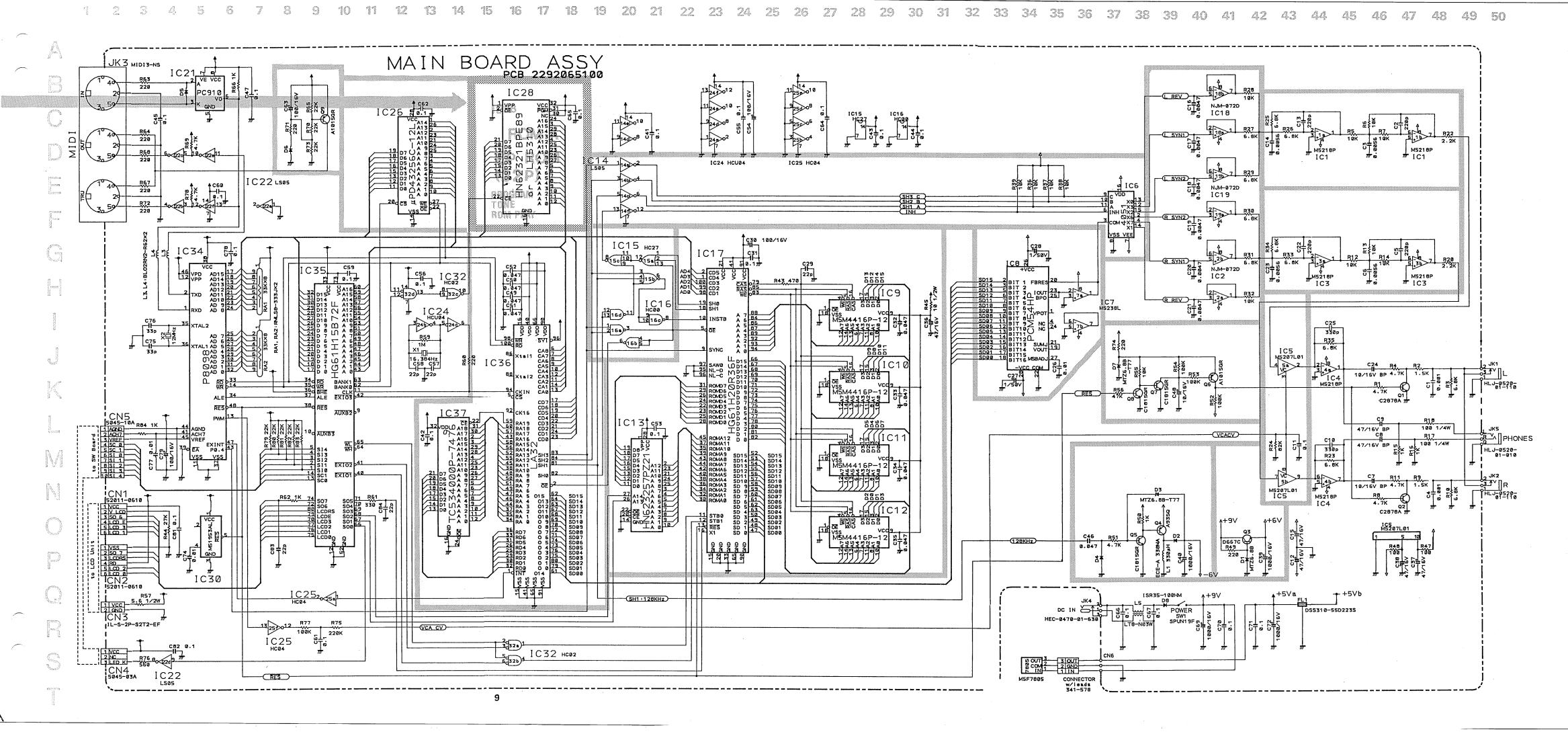
メイン基板上のROM(IC28)部分における基板シルク図及びパターン図はEP-ROM(32ピンタイプ)対応になっていますが、実際の製品において、ROM(IC28)はEP-ROM(32ピンタイプ)及びMask ROM(28ピンタイプ, LH5310**)の2種類が使用されています。このEP-ROM及びMask ROMは共に互換性が有り、サービスパーツにおいても、この2種類のうちいずれかで供給します。

ROM交換時は,EP-ROMとMask ROMではピン数が異なりますのでFig.1に従い注意して行ってください。



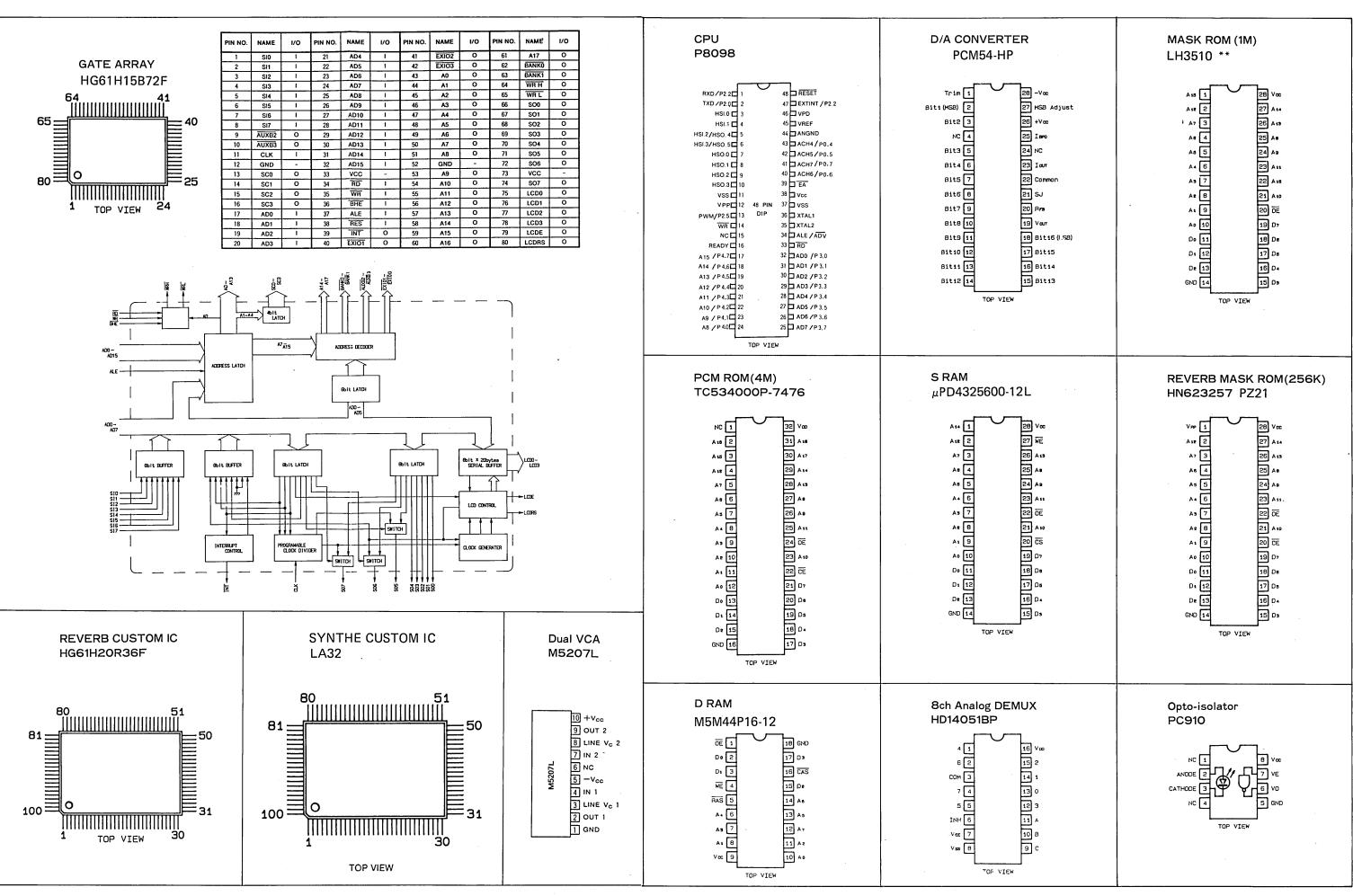
OCT. 1988 (3rd)

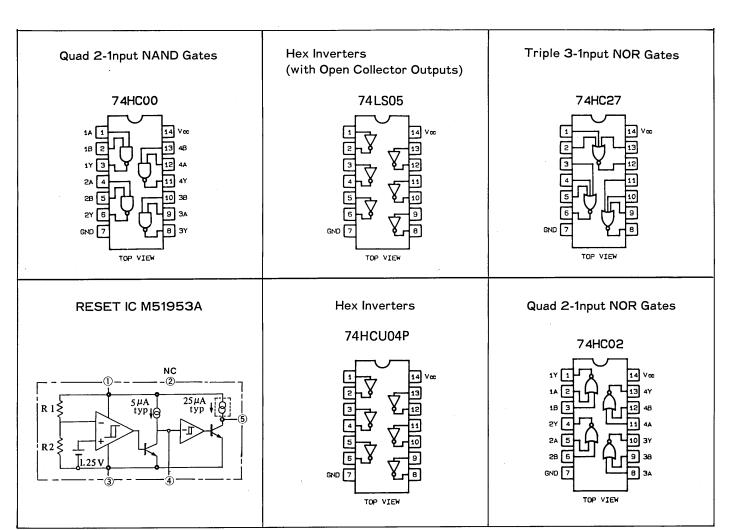
MT-32



MT-32

ic data





変更案内

注: ここに記載のROM(Ver.2.**)系 は新メイン基板 (7937731001) 用で旧メイン基板 (7937731000) 用のROM(Ver.1.**)系とは全く互換性は有りません。よってVer.2.00 からVer.2.03までのパグはROM(Ver.1.**)系においては全く問題有りません。

(但し、Ver.2.04の変更点B及びCは、Ver.1.00 - 1.08にも関係します。)

プログラム ROM (IC28 メイン基板)

Ver. [DATE]	IC28 (Part No.)	EFF.SN 実施製番	内容
2.00 [88-7-11]	Mask ROM LH5310HJ (15179916)	MT-32 Not released (Japanese only) "ミューシャ くん"用 DM-32N-3 2940150-Z940249 DM-32N-4 2943600-Z944599 DM-32N-7 2940750-Z941149	変更点(旧ゾイン基板のROM(Ver.1.**)系に対して) A: デフォルト時のアサインモードをマルチアサインにした。 B: パートの優先順位をR,1,2,3,4,5,6,7,8から1,2,3,4,5,6,7,8,Rに変更した。 C: トーングループ[r]'メズムス゚'メセットトーンの31から60を,1から30と同じものを繰り返すようにした。
2.01 2.02 2.03	Not released (使用せず)		
2.04	Mask ROM LH5310** (15179944) or EPROM (15179944)	MT-32 F950500-F950999 E969000-UP (Japanese only) "ミューシ"くん"用 DM-32N-3 Z950250以降 DM-32N-4 Z954600以降 DM-32N-7 Z951150以降	下記のバグ、症状が改善されています。 バグ (Ver.2.00にて新たに発生したもので、Ver.1.**系とは関係無し) A: データをリクエストされた時にリクエストされた範囲を越えてデータが返ってくる事が有る。 B: データをリクエストされた時に未定義アト・レスがリクエストされた場合、無意味なデータが出てくる事がある。 C: RQDを受信してDEVICE-IDが一致しない場合にEODのみを送る。 D: 複数パートのMIDIチャンネルを1回のエクスクルーシアで変更しようとしても最初のパートだけしか変わらない。但し、リクエストしても変更されたように見える。 E: ベングーレンジを変更するRPC(Registerd Parameter Control)のRPC*が2番になっている。(正しくは0番) F: リス、ムパートのKey#88以上の音でサスティンに入るとKey#24からのOutput Levelが効いてしまう。(88←24、89←25、90←26、MT-32は表向きはKey#88以上はサポートしていない。) G: 電源投入直後は、UNIT#でアクセスするティンバー・デンボラリー・エリア(Add 04 XX XX)のみ、データセット(DTI/DAT)が受け付けられない。症状 1. サート・パーティが発売している曲データのなかに、音抜けを起こすものが有る。(上記Ver.2.00の変更点Aの為) 2. ガモンミューシックのRCMーPC98での立ち上げ時に、"データ読み込みエラー接続を確認して下さい"と表示が出て、MT-32からデータが吸い上げられない。(上記のバケーAの為) 3. ダイナウェアのバラート・で、音をエディットが出来ない。また、サート・パーテの出している曲データのなかで、エクスクルーシアで音色データの中で、エクスクルーシアで音色データを送っているものがあれば、音色が変わらない可能性がある。(上記パケーGの為)
			変更点 A: 上記 Ver.2.00での変更点 A, B, Cを元に戻し、Ver.1.**系と同じにした。つまり、 * デフォルト時のアサインモート"をシングルアサインに戻した。 * パートの優先順位を1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, RからR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8に戻した。 * トーングループ[ア]リズムアッセットトーンの31から60迄をOFFに戻したB: リングのみのストラクチャで残っているパーシャルでリングを掛けられない場合に発音しないようにした。(Ver.1.00 - 1.08, Ver.2.00では、リングを掛けない音で鳴るので、異なる音が出るような感じになる。) C: 発音中に Key Shiftを変更すると自動的に発音を停止するようにした。(Ver.1.00 - 1.08, Ver.2.00では音が止まらなくなる。)

NOTE: Program ROM Version (IC28 on Main Board)

MT-32 F950500 - F950999 E969000 - UP

* The ROM version table above is for MT-32(Japanese version) only. Therefore the explanation in English is omitted.

- * For MT-32(117V,220V and 240V versions), ROM(IC28) has been released from Ver.2.04.
- * ROM(Ver.2.**) is mounted on (new) Main board(7937731001).
 ROM(Ver.1.**) is mounted on (old) Main board(7937731000).
 ROM(Ver.2.**) is not compatible with ROM(Ver.1.**).
 But the functions of them are almost same each other.